

性能特点：

- 频带：8GHz~12GHz
- 增益：29dB
- 输出 Psat：31dBm
- 功率附件效率：45%
- 供电：VGG=-1.3V,VDD=+5V@183mA
- 输入/输出回波损耗：14dB/12dB
- 芯片尺寸：3.35mm×2.75mm×0.1mm

产品简介：

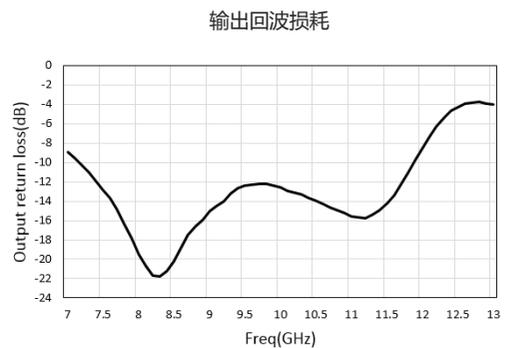
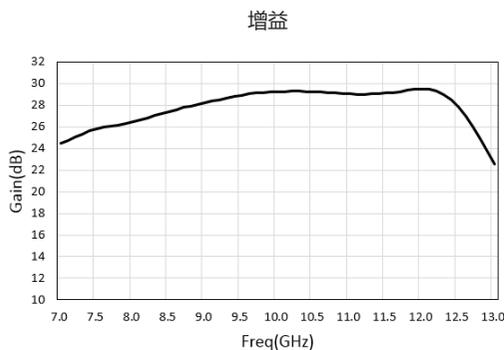
HH-PA0812A 是一款 GaAs MMIC 功率放大器芯片，其频率范围覆盖 8-12GHz。该芯片输出饱和功率 31dBm。

电参数：(TA=25°C)

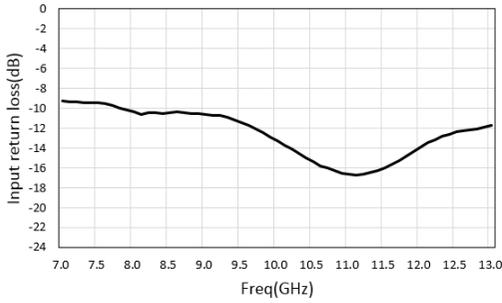
指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	8GHz~12GHz			GHz
增益	-	29	-	dB
输入回波损耗	-	14	-	dB
输出回波损耗	-	12	-	dB
输出 Psat	-	31	-	dBm
功率附件效率	-	45	-	%
静态工作电流	-	183	-	mA

使用限制参数：

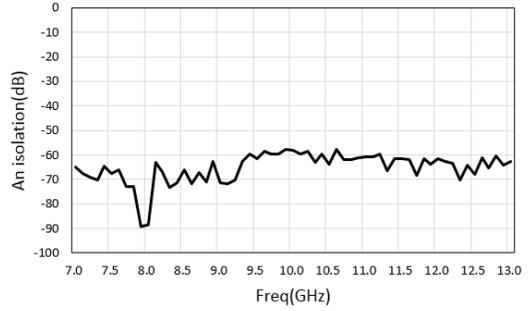
最大输入功率	15dBm
存储温度	-65°C-150°C
使用温度	-55°C-85°C

典型曲线：


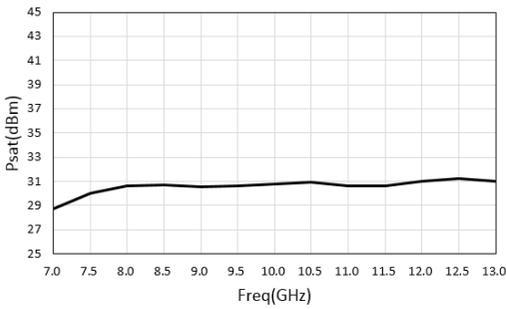
输入回波损耗



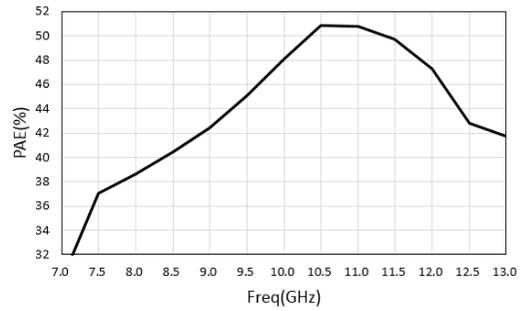
反向隔离



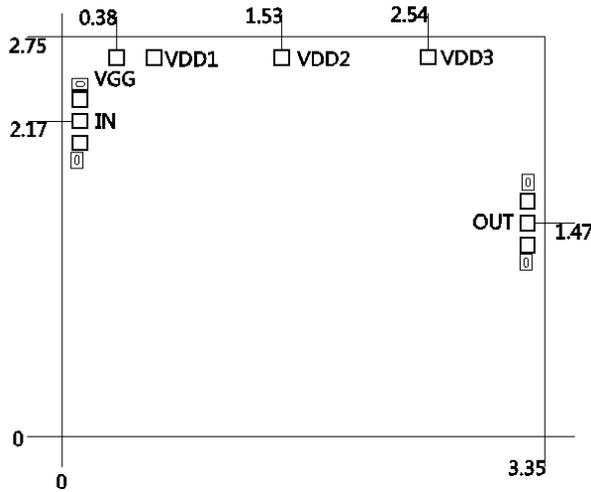
输出饱和功率



功率附加效率



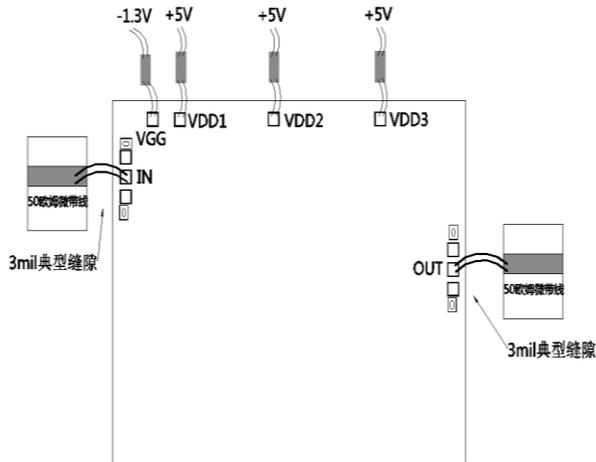
尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：

02

驱动 / 功率放大器



使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度 300um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）